

Institutskolloquium des IAVT im Rahmen des "Industrial Partnership Program" der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Dresden

Im Rahmen des 1. Industrie-Partner-Programm-Symposiums (IPP) der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik fand am 1.10.2008 ein Kolloquium des IAVT und des ZµP statt. Zugleich war dies das 51. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie (VDE/VDI).

Agenda

Einführungsvorträge

IAVT - Entwicklungskonzepte und strategische Partnerschaften

Hr. Prof. Wolter, IAVT

How Georgia Tech PRC works with its company partners

Hr. Prof. Tummala, Georgia Tech

Mikroelektronische Systeme für die Luft- und Raumfahrt

Hr. Dipl.-Ing. Kranhold, RHe Microsystems GmbH

Vorträge aus den Arbeitsrichtungen

Methodenapparat zur Qualifizierung einer bleifreien Montagetechnologie

Hr. Dr. Zerna, ZµP

Simulationsgestützte Planung und Steuerung von Fertigungsprozessen

Hr. Dr. Horn, Hr. Dr. Weigert, IAVT

Elektronikmaterialien unter biologischem Stress

Hr. Dr. Uhlemann, IAVT

Qualitätssicherungsmethoden in Fertigungsprozessen der Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Hr. Dr. Wohlraabe, ZµP

Methoden zur Bewertung der Zuverlässigkeit elektronischer Baugruppen

Hr. Dr. Röllig, IAVT

Kurzvorträge zur Posterausstellung

Surface degradation of Sn-contained electronic packaging materials in simulated body fluids

Fr. Dipl.-Ing. Beshchasna, IAVT

Material Characterization of Organic Packaging Materials to Increase the Accuracy of FEM Based Stress Analysis

Hr. Dipl.-Ing. Böhme, IAVT

Material characterization with the ultrasonic microscope

Hr. Dipl.-Ing. Gust, IAVT

Methods for Modelling and Optimization of Assembly Processes

Hr. Dipl.-Ing. Henlich, IAVT

Simulationsgestützte Ablaufplanung und –steuerung in der Halbleiterfertigung

Hr. Dr.-Ing. Horn, IAVT

Optimization Strategies for Manufacturing Problems

Hr. Dr.-Ing. Horn, Hr. Dipl.-Ing. Klemmt, IAVT

Characterisation of the Mechanical Behaviour of Lead-Free Solder Joints at High Strain Rates

Hr. Dipl.-Ing. Meier, IAVT

Data mining for electronics packaging applications

Hr. Dipl.-Ing. Meyer, IAVT

Microstructure of SnAgCu Solder Spheres

Hr. Dipl.-Ing. Müller, IAVT

Novel Optical Transmitter and Receiver for Parallel Optical Interconnects on PCB-Level

Hr. Dipl.-Ing. Nieweglowski, IAVT

Fine pitch Cu wire bond process for integrated circuit devices for high volume production

Hr. Dipl.-Ing. Schindler, IAVT

Charakterisierung dünner Schichten mit der akustisch angeregten Rasterkraftmikroskopie

Hr. Dipl.-Ing. Striegler, IAVT